

## CONTENTS 目次

Industry Data	C2
インダストリー・データ	
Tokyo Electron (TEL) Overview	1
東京エレクトロン(TEL)の事業概要	
Global TEL	2
TELの世界展開	
Topics in Recent Years	3
近年のトピックス	
Semiconductor & TFT-LCD Manufacturing Process Flow	4
半導体製造工程及び TFT-LCD製造工程	
Consolidated Operating Results	6
連結業績	
Semiconductor Production Equipment (SPE) and FPD/PV Production Equipment	8
半導体製造装置・FPD/PV製造装置	
Consolidated Financial Data	10
連結財務データ	
Consolidated Balance Sheets	14
連結貸借対照表	
Consolidated Statements of Operations	16
連結損益計算書	
Consolidated Statements of Cash Flows	17
連結キャッシュ・フロー計算書	
Consolidated Quarterly Data	18
連結四半期データ	
Stock Information	20
株式情報	

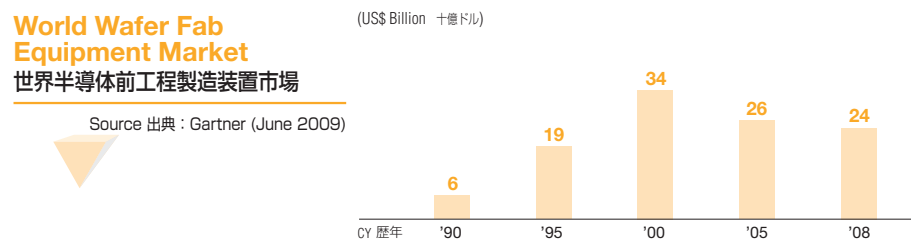
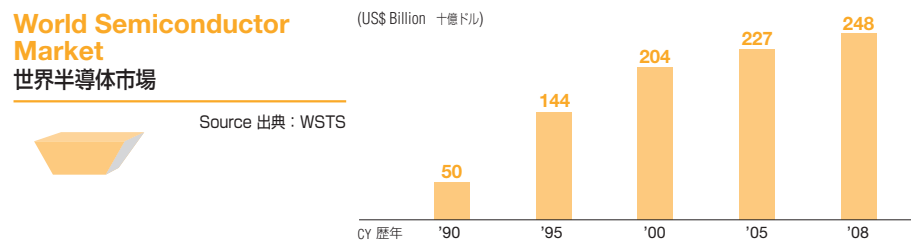
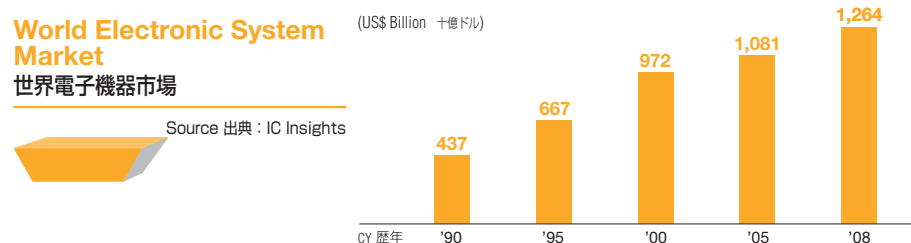
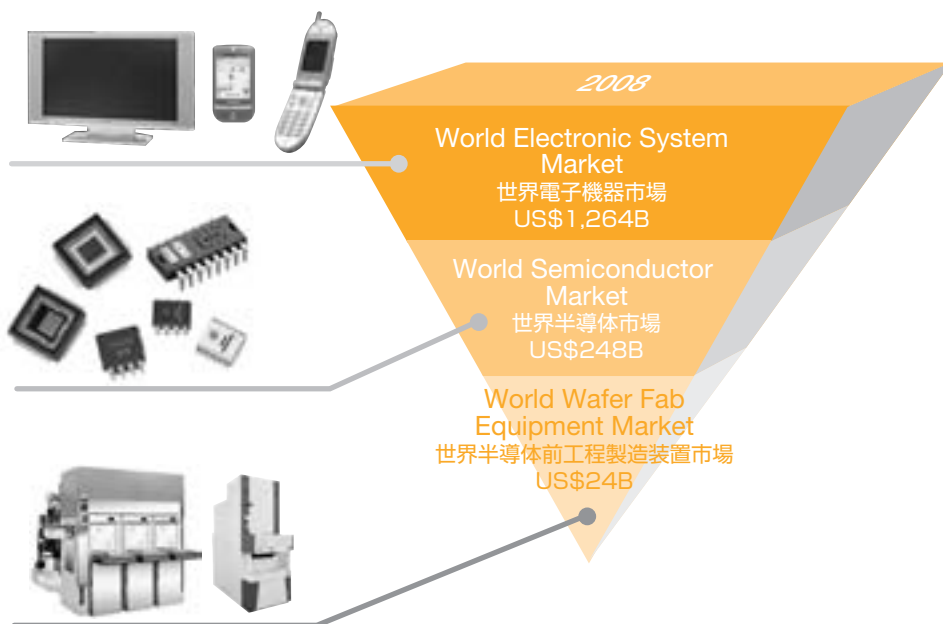
# TOKYO

# ELECTRON

# 2009

As of March 31, 2009

# FACT BOOK



World TOP 10 Semiconductor Production Equipment Manufacturers 半導体製造装置メーカー世界トップ10

CY 1995	
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	Nikon ニコン
4	Canon キヤノン
5	Lam Research ラム・リサーチ
6	Advantest アドバンテスト
7	Hitachi 日立
8	Teradyne テラダイン
9	Dainippon Screen 大日本スクリーン
10	Varian バリアン

CY 2000	
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	Nikon ニコン
4	Teradyne テラダイン
5	ASM Lithography エー・エス・エム リソグラフィ
6	KLA-Tencor ケーエルエー・テンコール
7	Advantest アドバンテスト
8	Lam Research ラム・リサーチ
9	Canon キヤノン
10	Dainippon Screen 大日本スクリーン

CY 2005	
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	ASM Lithography エー・エス・エム リソグラフィ
4	KLA-Tencor ケーエルエー・テンコール
5	Advantest アドバンテスト
6	Nikon ニコン
7	Lam Research ラム・リサーチ
8	Novellus Systems ノベラス システムズ
9	Hitachi High-Technologies 日立ハイテクノロジーズ
10	Canon キヤノン

CY 2008	
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	ASM Lithography エー・エス・エム リソグラフィ
3	Tokyo Electron 東京エレクトロン
4	KLA-Tencor ケーエルエー・テンコール
5	Lam Research ラム・リサーチ
6	Nikon ニコン
7	Canon キヤノン
8	Hitachi High-Technologies 日立ハイテクノロジーズ
9	Dainippon Screen 大日本スクリーン
10	Novellus Systems ノベラス システムズ

Source 出典: VLSI Research

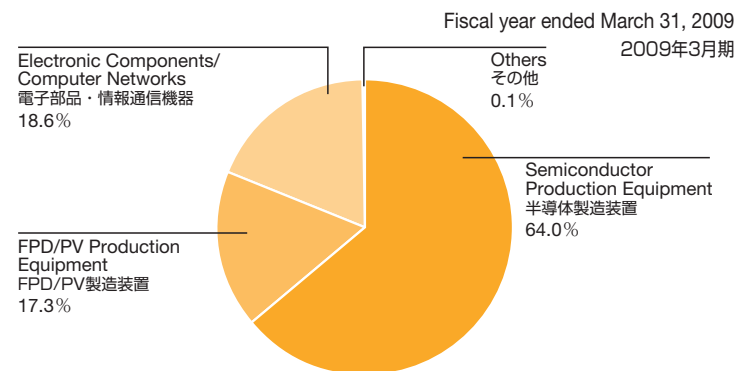
Corporate Information

会社概要

<p><b>Corporate Name</b> 商号</p> <p><b>World Headquarters</b> 本社所在地</p> <p><b>Established</b> 設立</p> <p><b>Capital</b> 資本金</p>	<p>Tokyo Electron Limited 東京エレクトロン株式会社</p> <p>Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー</p> <p>November 11, 1963 1963年11月11日</p> <p>¥54.9 Billion (as of March 31, 2009) 549億円 (2009年3月31日現在)</p>
---	---

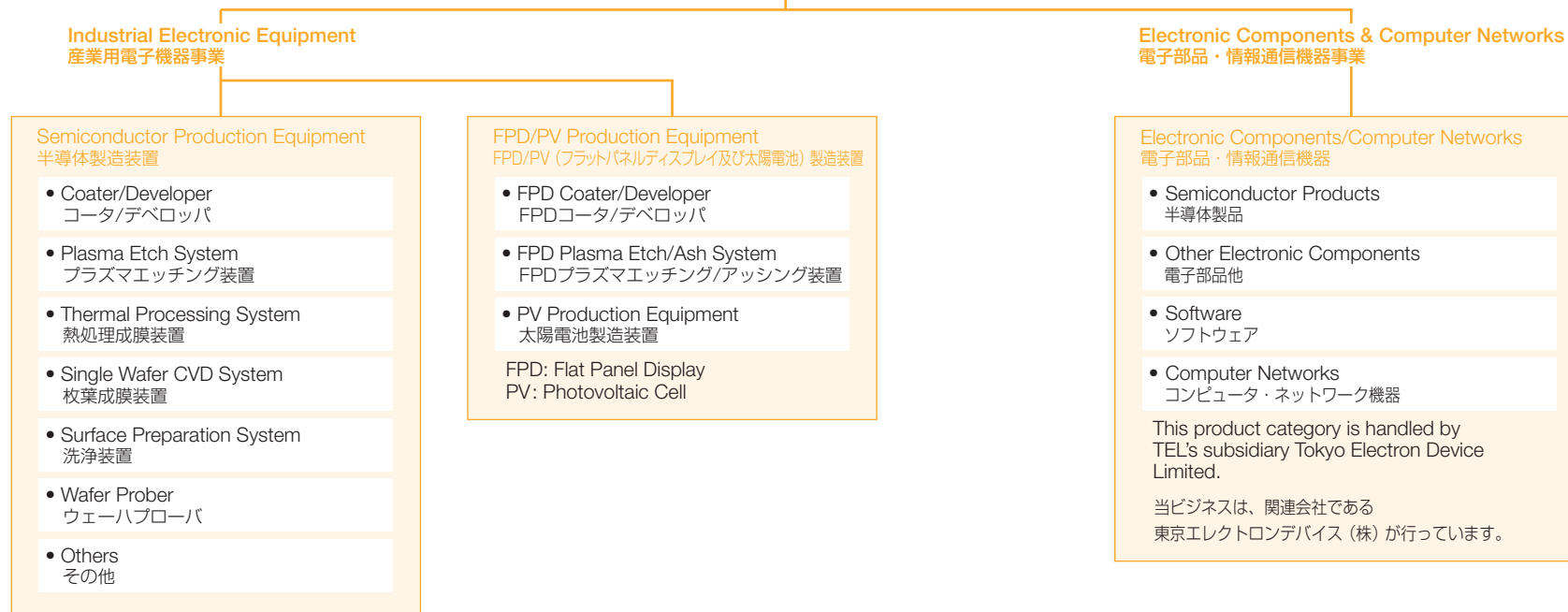
Composition of Net Sales by Division

部門別売上構成比



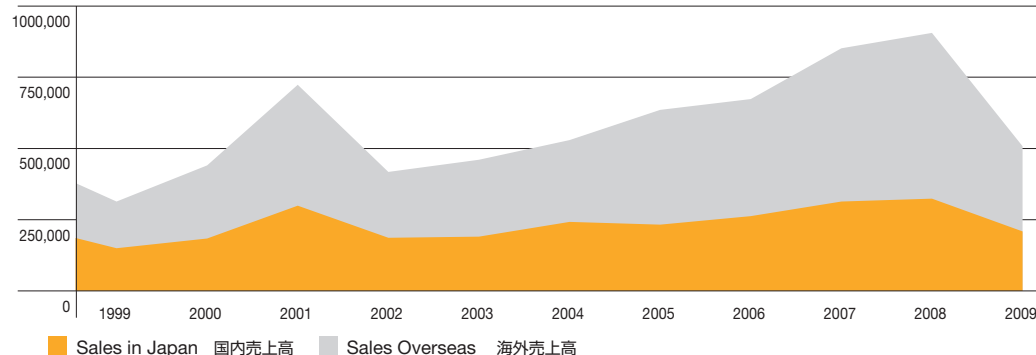
Major Products and Services  
主要取扱製品

As of April 1, 2009 (2009年4月1日現在)



## Consolidated Sales in Japan and Overseas

連結国内・海外売上高推移

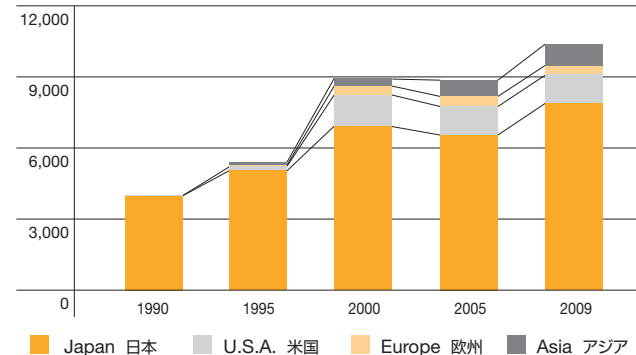


FY 年度	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sales in Japan 国内売上高	149,837	183,987	299,272	186,516	190,513	242,318	232,677	262,531	313,816	323,946	208,870
Sales overseas 海外売上高	163,982	256,741	424,608	231,309	270,067	287,335	403,032	411,154	538,159	582,145	299,211
Total 合計	313,820	440,728	723,880	417,825	460,580	529,653	635,710	673,686	851,975	906,091	508,082

(¥ Million 百万円)

## Number of Employees Worldwide

ワールドワイド人員推移

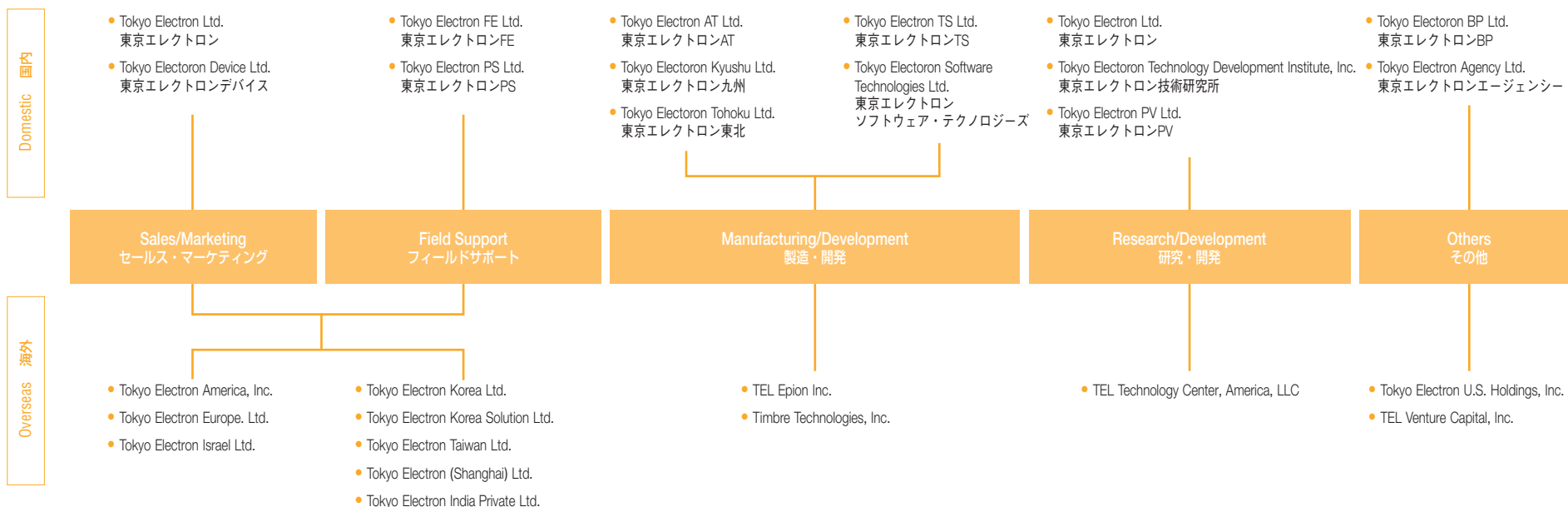


FY 年度	1990	1995	2000	2005	2009
Japan 日本	3,980	5,041	6,922	6,548	7,865
U.S.A. 米国	8	192	1,315	1,205	1,226
Europe 欧州	0	51	378	425	376
Asia アジア	0	126	331	686	924
Total 合計	3,988	5,410	8,946	8,864	10,391

(Person 人)

## Tokyo Electron Group 東京エレクトロングループ

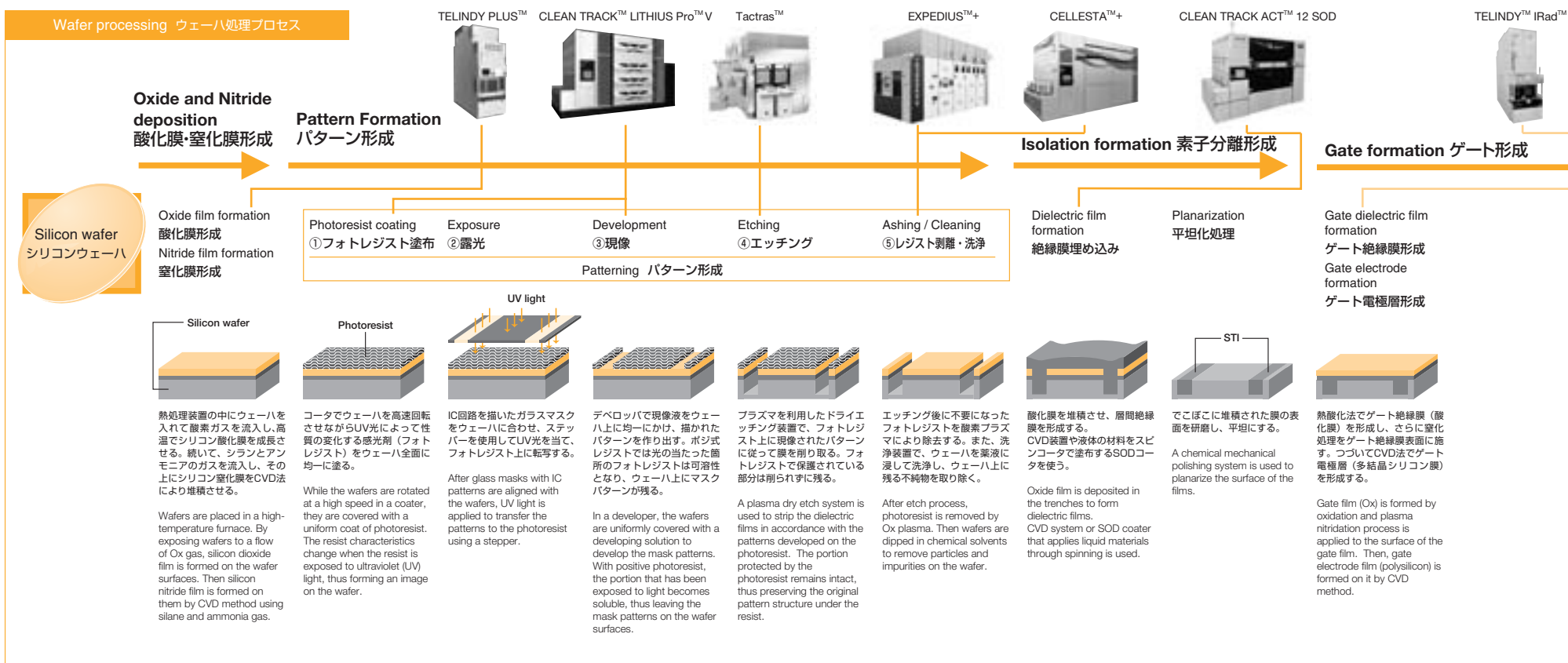
As of April 1, 2009 (2009年4月1日現在)



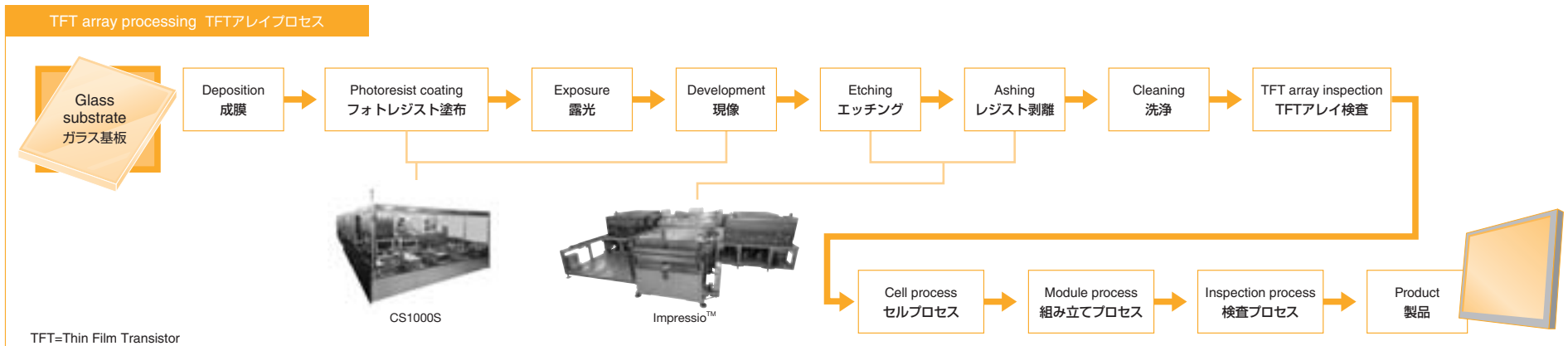
<p>1998</p>	<p><b>2月</b> Feb</p> <p>Construction of a new facility at the Process Technology Center capable of handling 300mm wafers was completed in Hosaka, Yamanashi Prefecture. 山梨穂坂地区に300mmウェーハ対応プロセステクノロジーセンター新棟が完成</p>	<p><b>8月</b> Aug</p> <p>TEL Technology Center, America, LLC (TTCA) established in the U.S. to conduct research and development of cutting-edge semiconductor materials and processes. 米国に先進的な半導体材料およびプロセスの研究を行うTEL Technology Center, America, LLC (TTCA)を設立</p>	<p><b>4月</b> Apr</p> <p>Tokyo Electron AT was split into three – Tokyo Electron AT Ltd., Tokyo Electron Tohoku Ltd. and Tokyo Electron TS Ltd. 東京エレクトロンAT (株) を分割し、東京エレクトロンAT (株)、東京エレクトロン東北 (株)、東京エレクトロンTS (株) を設立</p>
<p>1999</p>	<p><b>10月</b> Oct</p> <p>TEL's sector classification in the First Section of the Tokyo Stock Exchange was changed from "Wholesale Trade" to "Electric Appliances". 東証第1部における業種を「商業」から「電気機器」へ変更</p>	<p>2004</p> <p><b>4月</b> Apr</p> <p>Tokyo Electron AT Ltd. (surviving company) and Tokyo Electron Tohoku Ltd., manufacturing subsidiaries in Japan, merged. 国内製造拠点、東京エレクトロンAT (株) (存続会社) と東京エレクトロン東北 (株) が合併</p>	<p><b>6月</b> Jun</p> <p>TEL Venture Capital, Inc. established 米国にTEL Venture Capital, Inc.を設立</p> <p><b>12月</b> Dec</p> <p>TEL acquired Epion Corporation, a supplier of gas cluster ion beam technology. ガスクラスタライオンビーム技術を有する米国・Epion社を買収</p>
<p>2000</p>	<p><b>8月</b> Aug</p> <p>The trading unit for TEL stock was changed from 1,000 shares to 100 shares. 1単位の株式数を1,000株から100株に変更</p>	<p><b>7月</b> Jul</p> <p>Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. established in the U.S. It controls Tokyo Electron America, Tokyo Electron Massachusetts and TEL Technology Center, America. 米国に持株会社Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc.を設立。米国内現地法人Tokyo Electron America, Inc., Tokyo Electron Massachusetts, LLC, TEL Technology Center, America, LLCを傘下に入れる</p>	<p>2007</p> <p><b>2月</b> Feb</p> <p>Tokyo Electron PS Ltd. established. ポストセールス専門のエンジニアリング会社・東京エレクトロンPS (株) を設立</p>
<p>2001</p>	<p><b>2月</b> Feb</p> <p>TEL acquired a stake in Timbre Technologies, Inc., a leader in advanced metrology. 最先端の計測ソフトウェア技術を有する米国Timbre Technologies, Inc.を買収し子会社にする</p>	<p>2005</p> <p><b>1月</b> Jan</p> <p>TEL received the Superior Corporate Disclosure Award from the Tokyo Stock Exchange for the second time, the first time being in 1999. 東証より、1999年に引き続き2度目の「ディスクロージャー優良企業」に選定され、受賞</p>	<p><b>6月</b> Jun</p> <p>RLSA Division spun off and Tokyo Electron Technology Development Institute, Inc. established. RLSA事業部門を分社化し、東京エレクトロン技術研究所 (株) を設立</p>
<p>2002</p>	<p><b>4月</b> Apr</p> <p>Tokyo Electron (Shanghai) Ltd. established. Tokyo Electron (Shanghai) Ltd.を設立</p> <p><b>11月</b> Nov</p> <p>TEL participated in the Albany NanoTech project promoted by New York State. ニューヨーク州が推進する研究開発推進支援プログラム「アルバニー・ナノテック」プロジェクトへ参加</p>	<p>2006</p> <p><b>2月</b> Feb</p> <p>Tokyo Electron Korea Solution Ltd. established. Tokyo Electron Korea Solution Ltd. を設立</p>	<p>2008</p> <p><b>2月</b> Feb</p> <p>Tokyo Electron PV Ltd., a joint venture with Sharp Corp., established to develop plasma CVD systems for thin-film silicon photovoltaic cells. シャープ (株) と合併で薄膜シリコン太陽電池用プラズマCVD製造装置の開発を目的として東京エレクトロンPV (株) を設立</p>
<p>2003</p>	<p><b>3月</b> Mar</p> <p>Tokyo Electron Device Ltd. listed on the 2nd Section of the Tokyo Stock Exchange. 東京エレクトロンデバイス (株) 東京証券取引所第2部に上場</p>		<p>2009</p> <p><b>2月</b> Feb</p> <p>TEL became the exclusive representative in Asia and Oceania for Oerlikon Solar, a Switzerland-based leading supplier of photovoltaic cell production equipment. 太陽電池製造装置大手、スイスのエリコンソーラー社のアジア、オセアニア地域での独占販売代理店となる</p>

The fabrication processes (wafer processing and TFT array process) essential for manufacturing semiconductors and TFT-LCDs are similar.  
半導体やTFT-LCD製造の要となる前工程（ウェーハ処理プロセス、TFTアレイプロセス）は、ともによく似た工程です。

**Semiconductor manufacturing process 半導体製造プロセス**



**TFT-LCD manufacturing process TFT-LCD製造プロセス**



TELFORMULA™ Trias™ SPA i / Trias™ High-k CVD



Trias™



Precio™

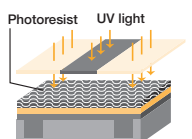


**Interconnect formation  
配線形成**

**Wafer test  
ウェーハ検査**

Probe Testing  
プローブ検査

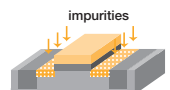
**Patterning  
パターン形成**



ゲート電極層上にパターン形成プロセスを施し、ソース・ドレイン領域をつくる。

Source and drain areas are made by applying patterning processes to the gate electrode layer.

**Ion implantation  
イオン注入  
Annealing  
アニール**



ソース・ドレイン領域にイオン注入法で導入した元素（ホウ素や砒素等）を打ち込む。酸化膜が残っている部分にはイオンが注入されない。その後、高温アニールによって不純物を均一に拡散させる。

An ion implanter dopes the source and drain areas with impurities, such as boron and arsenic. Ox films prevent dopant ions from being implanted in other areas. Subsequent annealing diffuses these impurities to a more uniform density.

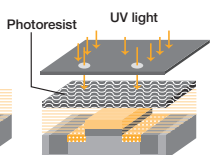
**Intermetal dielectric film formation  
層間絶縁膜形成  
Planarization  
平坦化処理**



酸化膜をCVD法で堆積させ層間絶縁膜を形成し、表面を研磨して平坦化する。

Intermetal dielectric film is formed by oxide using CVD method and the film surface is planarized by polishing system subsequently.

**Patterning  
パターン形成**



絶縁膜上にパターン形成プロセスを施し、コンタクトホールを開く。

Contact holes are opened by applying patterning processes to the dielectric film surface.

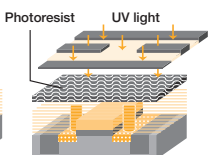
**Contact formation  
コンタクト形成**



CVD法で金属膜を埋め込む。余分な膜は研磨で除去する。

The holes are filled with metal film by CVD, then excess metal is removed by polishing.

**Patterning  
パターン形成**



低誘電率膜等の層間絶縁膜を堆積する。次にパターン形成を行い配線となる部分（トレンチ）を開く。

Low-dielectric-constant film is deposited followed by trench formation in the film by patterning process.

**Interconnect formation  
配線形成**



トレンチに金属膜を埋め込み余分な膜を研磨し除去する。

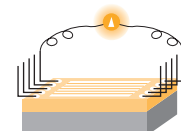
Metal films are filled into the trench and excess metals are polished.

**Interconnect formation  
配線形成**



層間絶縁膜堆積～金属膜埋め込み/研磨の一連のプロセスを必要な配線層数分繰り返す

Processes from dielectric film formation to metal polishing are repeated to make a multi level interconnect.



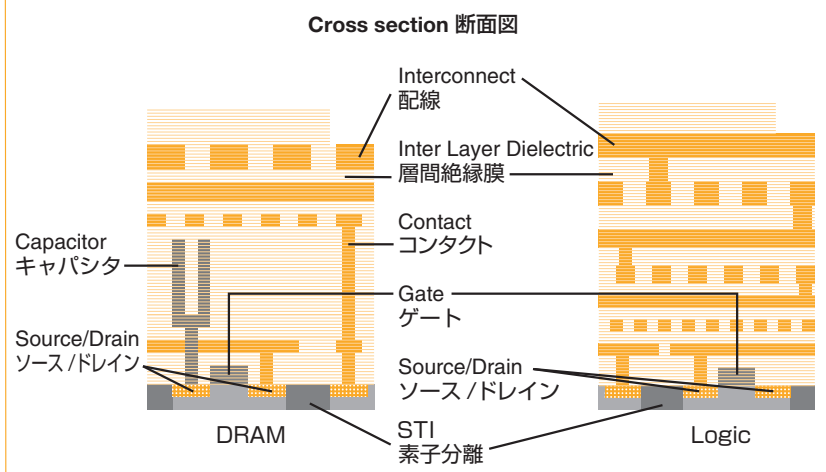
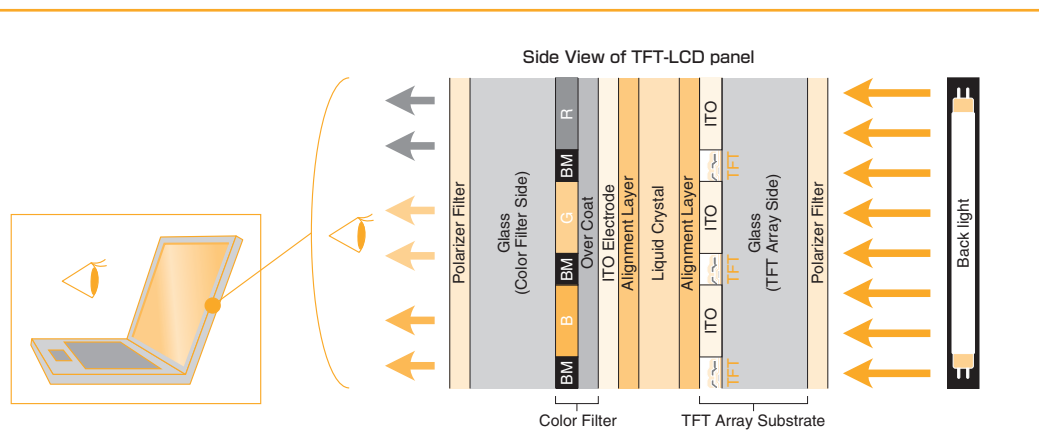
でき上がったウェーハには同じLSIチップが数百個作られている。プローブで1つ1つのチップにプローブ針を接触させ、つないだデスターと信号のやりとりをしながらチップの良・不良を電氣的に検査する。

There are several hundreds of identical LSI chips on a fabricated wafer. Prober makes pins contact chips, and tests whether chips are good or bad electrically by exchanging signals.

Assembly process  
組立プロセス

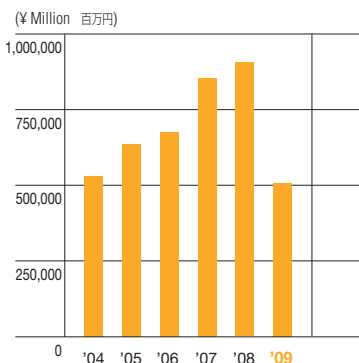
Inspection process  
検査プロセス

Product  
製品

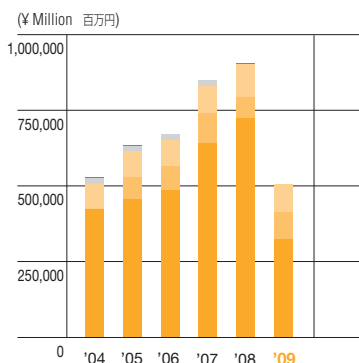


TEL's fiscal year ends on March 31. Each fiscal year described in this document is identified by the year in which it ends. For example, FY2009 is the fiscal year ended March 31, 2009. 当社は3月31日を決算日としています。本誌記載の年度は各営業期間の終了した会計年度です。例えば、FY2009は2009年3月31日に終了した会計年度です。

**Net Sales**  
売上高

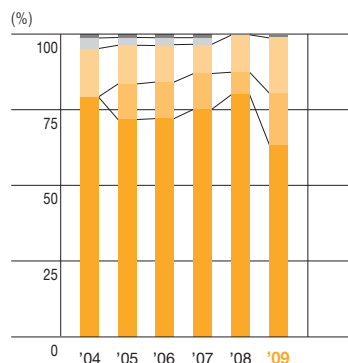


**Net Sales by Division**  
部門別売上高

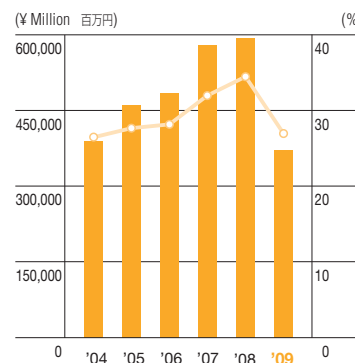


■ Semiconductor production equipment 半導体製造装置  
■ FPD/PV production equipment FPD/PV製造装置  
■ Electronic components 電子部品  
■ Computer networks コンピュータ・ネットワーク  
■ Others その他

**Composition of Net Sales by Division**  
部門別売上構成比

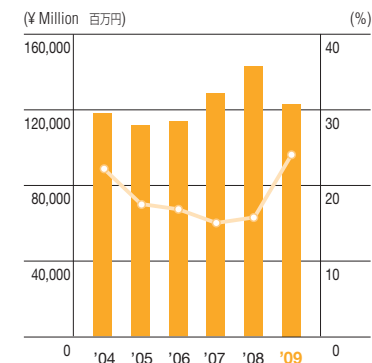


**Cost of Sales and Gross Profit Margin**  
売上原価及び売上総利益率



■ Cost of sales 売上原価  
○ Gross profit margin 売上総利益率

**Selling, General and Administrative Expenses and Ratio to Net Sales**  
販売費及び一般管理費及び対売上高比率



■ SG&A expenses 販売費及び一般管理費  
○ SG&A expenses ratio 販管費率

Electronic Components & Computer Networks reclassified from FY2008  
2008年3月期より電子部品・情報通信機器

FY	Net sales	(% of total)	Semiconductor production equipment	FPD/PV production equipment	Electronic components	Computer networks	Others
年度	売上高	構成比	半導体製造装置	FPD/PV製造装置	電子部品	コンピュータ・ネットワーク	その他
2004	529,653	(100.0)	425,747 (80.4)	—	84,229 (15.9)	18,447 (3.5)	1,229 (0.2)
2005	635,710	(100.0)	457,190 (71.9)	75,038 (11.8)	86,249 (13.6)	15,966 (2.5)	1,266 (0.2)
2006	673,686	(100.0)	486,882 (72.3)	81,176 (12.0)	86,880 (12.9)	17,497 (2.6)	1,248 (0.2)
2007	851,975	(100.0)	642,625 (75.4)	100,766 (11.8)	88,293 (10.4)	19,168 (2.2)	1,120 (0.2)
2008	906,091	(100.0)	726,439 (80.2)	68,016 (7.5)	111,181 (12.3)	—	454 (0.0)
<b>2009</b>	<b>508,082</b>	<b>(100.0)</b>	<b>325,383 (64.0)</b>	<b>88,107 (17.3)</b>	<b>94,207 (18.6)</b>	<b>—</b>	<b>384 (0.1)</b>

Sales by division represents the sales to customers.  
部門別売上高は、外部顧客に対する売上高です。

FY	Cost of sales	Gross profit margin
年度	売上原価	売上総利益率
2004	389,498	26.5
2005	459,797	27.7
2006	483,954	28.2
2007	579,325	32.0
2008	594,794	34.4
<b>2009</b>	<b>370,673</b>	<b>27.0</b>

FY	SG&A expenses	Ratio to net sales
年度	販売費及び一般管理費	対売上高比率
2004	117,875	22.3
2005	111,929	17.6
2006	114,028	17.0
2007	128,670	15.1
2008	142,799	15.8
<b>2009</b>	<b>122,697</b>	<b>24.1</b>

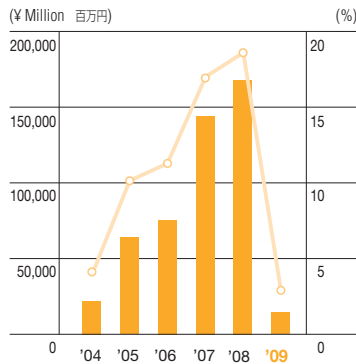
- Notes: 1. Some of the field engineering expenses of service-related subsidiaries, which were previously included in selling, general and administrative expenses, are classified as cost of sales from FY2004.  
 2. From FY2005, sales of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis.  
 3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.  
 4. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".  
 5. From FY2008, sales of "Electronic components" and "Computer networks", which were disclosed separately, are combined as "Electronic Components & Computer Networks".  
 6. From FY2009, FPD production equipment and PV (Photovoltaic Cell) production equipment sales are disclosed together.

- 注) 1. 2004年3月期より、従来販売費及び一般管理費に含めていたサービス子会社のフィールドエンジニアリングに関わる費用を売上原価に変更しました。  
 2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高に含めていたFPD製造装置の売上高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。  
 3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更 (2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更  
 4. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。  
 5. 2008年3月期より、従来電子部品およびコンピュータ・ネットワークで個別に開示していた売上高を、電子部品・情報通信機器として開示しています。  
 6. 2009年3月期より、FPD製造装置とPV (太陽電池) 製造装置の売上を合わせて開示しています。



## Operating Income and Operating Margin

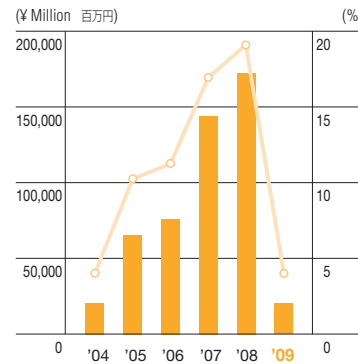
営業損益及び営業利益率



■ Operating income (loss) 営業損益  
○ Operating margin 営業利益率

## Ordinary Income and Ordinary Profit Margin

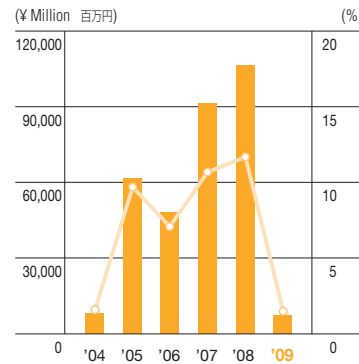
経常損益及び経常利益率



■ Ordinary income (loss) 経常損益  
○ Ordinary profit margin 経常利益率

## Net Income and Net Income Margin

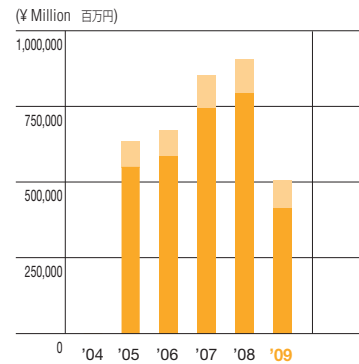
当期損益及び当期利益率



■ Net income (loss) 当期損益  
○ Net income margin 当期利益率

## Net Sales by Business Segment

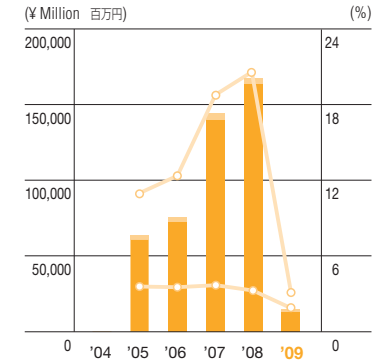
セグメント別売上高



■ Industrial electronic equipment 産業用電子機器事業  
■ Electronic components & Computer networks 電子部品・情報通信機器事業

## Operating Income and Operating Margin by Business Segment

セグメント別営業利益・営業利益率



■ Industrial electronic equipment 産業用電子機器事業  
■ Electronic components & Computer networks 電子部品・情報通信機器事業  
○ Operating margin 営業利益率

FY	Operating income (¥ Million)	Operating margin (%)
年度	営業損益	営業利益率
2004	22,279	4.2
2005	63,982	10.1
2006	75,703	11.2
2007	143,978	16.9
2008	168,498	18.6
2009	14,710	2.9

FY	Ordinary income (¥ Million)	Ordinary profit margin (%)
年度	経常損益	経常利益率
2004	21,167	4.0
2005	65,632	10.3
2006	75,951	11.3
2007	143,940	16.9
2008	172,713	19.1
2009	20,555	4.0

FY	Net income (¥ Million)	Net income margin (%)
年度	当期損益	当期利益率
2004	8,297	1.6
2005	61,601	9.7
2006	48,005	7.1
2007	91,262	10.7
2008	106,271	11.7
2009	7,543	1.5

FY	Industrial electronic equipment (¥ Million)		Electronic components & Computer networks (¥ Million)	
	Industrial electronic equipment	Electronic components & Computer networks	Industrial electronic equipment	Electronic components & Computer networks
年度	産業用電子機器事業	電子部品・情報通信機器事業	産業用電子機器事業	電子部品・情報通信機器事業
2004	—	—	—	—
2005	550,514 (86.2)	88,079 (13.8)	550,514 (86.2)	88,079 (13.8)
2006	587,809 (86.9)	88,290 (13.1)	587,809 (86.9)	88,290 (13.1)
2007	746,893 (87.3)	108,709 (12.7)	746,893 (87.3)	108,709 (12.7)
2008	796,027 (87.7)	112,128 (12.3)	796,027 (87.7)	112,128 (12.3)
2009	414,816 (81.4)	94,701 (18.6)	414,816 (81.4)	94,701 (18.6)

FY	Industrial electronic equipment (¥ Million)		Electronic components & Computer networks (¥ Million)	
	Operating income	Operating margin (%)	Operating income	Operating margin (%)
年度	営業利益	営業利益率 (%)	営業利益	営業利益率 (%)
2004	—	—	—	—
2005	60,790	11.0	3,106	3.5
2006	72,568	12.3	3,100	3.5
2007	140,354	18.8	3,969	3.7
2008	164,807	20.7	3,658	3.3
2009	12,843	3.1	1,840	1.9

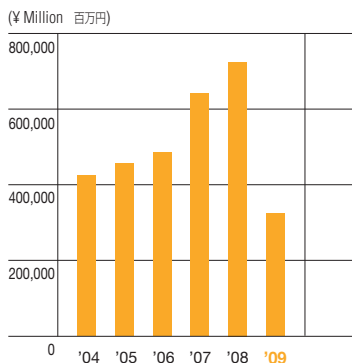
\* 1 : Semiconductor production equipment, FPD/PV production equipment, Other 半導体製造装置、FPD/PV製造装置、その他  
\* 2 : Electronic components, Computer networks 電子部品、コンピュータ・ネットワーク  
Sales of Computer networks were included in segment " \* 1 " before FY2006 コンピュータ・ネットワークは、2006年3月期以前は \* 1 に含まれます。  
Sales include inter-segment transactions. 売上高は、セグメント間取引を含んでいます。

Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.  
2. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".  
3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更  
2. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。  
3. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

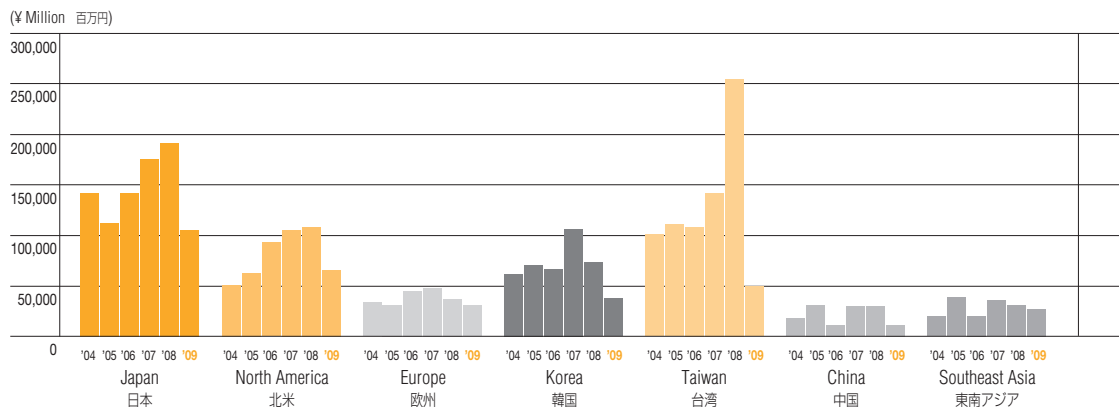
## SPE Sales

## 半導体製造装置売上高



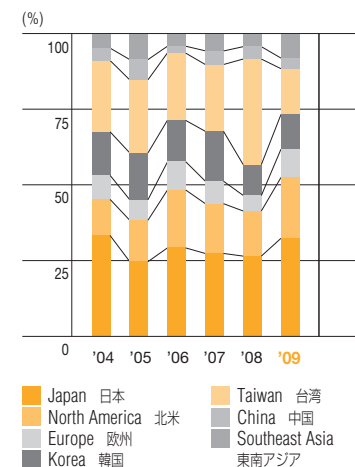
## SPE Sales by Region

## 半導体製造装置地域別売上高



## Composition of SPE Sales by Region

## 半導体製造装置地域別売上構成比



FY	SPE Sales (¥ Million)
2004	425,747
2005	457,190
2006	486,882
2007	642,625
2008	726,439
2009	325,383

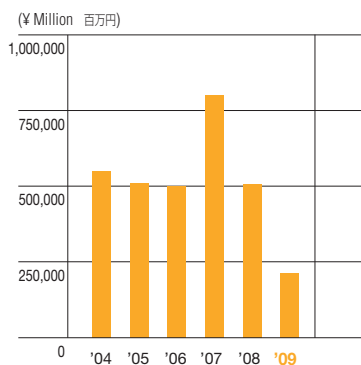
FY	Japan (%)	North America (%)	Europe (%)	Korea (%)	Taiwan (%)	China (%)	Southeast Asia (%)	Total (¥ Million)
2004	33.3	11.9	8.0	14.4	23.6	4.1	4.7	425,747
2005	24.6	13.7	6.8	15.5	24.2	6.7	8.5	457,190
2006	29.2	19.2	9.3	13.8	22.2	2.2	4.1	486,882
2007	27.3	16.4	7.5	16.5	22.1	4.6	5.6	642,625
2008	26.4	15.0	5.1	10.1	35.1	4.1	4.2	726,439
2009	32.4	20.1	9.3	11.5	15.2	3.4	8.1	325,383

- Notes: 1. From FY2005, revenues from semiconductor and FPD production equipment, which were recognized at the time of shipment in previous years, are recognized at the confirmation of set-up and testing of products.  
 2. From FY2005, sales, orders and order backlog of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis. Those figures of SPE in the above graphs and tables until FY2004 include those of FPD production equipment.  
 3. Geographical sales are classified according to sales destinations.

- 注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更しています。  
 2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高に含めていたFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。尚、上記グラフおよびテーブルの2004年3月期までの半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高にはFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を含めて表示しています。  
 3. 地域別売上高は、販売先の所在地に基づいています。

## SPE Orders Received

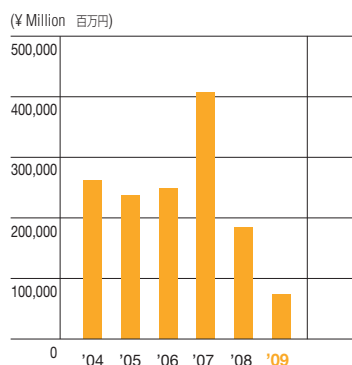
半導体製造装置受注高



FY	SPE orders received (¥ Million)
2004	549,773
2005	510,536
2006	499,862
2007	800,434
2008	504,116
2009	214,517

## SPE Order Backlog

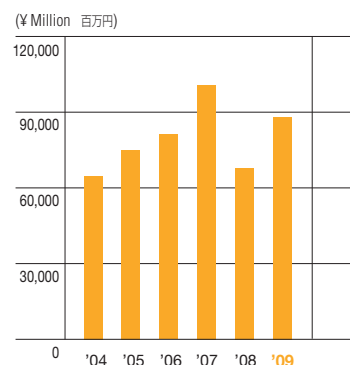
半導体製造装置受注残高



FY	SPE order backlog (¥ Million)
2004	262,340
2005	236,179
2006	249,159
2007	406,969
2008	184,645
2009	73,780

## FPD/PV Production Equipment Sales

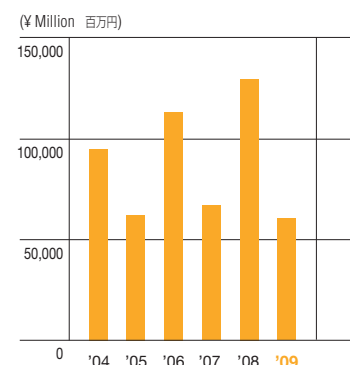
FPD/PV製造装置売上高



FY	FPD/PV production equipment sales (¥ Million)
2004	64,769
2005	75,038
2006	81,176
2007	100,766
2008	68,016
2009	88,107

## FPD/PV Production Equipment Orders Received

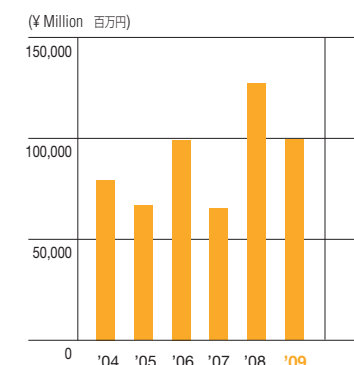
FPD/PV製造装置受注高



FY	FPD/PV production equipment orders received (¥ Million)
2004	95,030
2005	62,282
2006	113,494
2007	66,908
2008	129,906
2009	60,579

## FPD/PV Production Equipment Order Backlog

FPD/PV製造装置受注残高



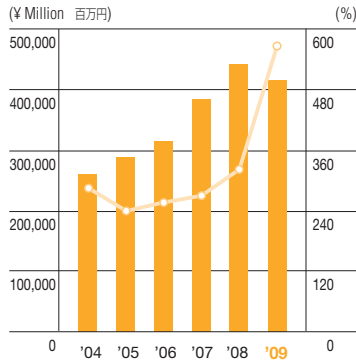
FY	FPD/PV production equipment order backlog (¥ Million)
2004	79,492
2005	66,751
2006	99,069
2007	65,211
2008	127,101
2009	99,573

Notes: 1. From FY2005, revenues from semiconductor and FPD production equipment, which were recognized at the time of shipment in previous years, are recognized at the confirmation of set-up and testing of products.  
2. From FY2005, sales, orders and order backlog of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis. Those figures of SPE in the above graphs and tables until FY2004 include those of FPD production equipment.  
3. From FY2009, sales, orders and order backlog of FPD production equipment and PV (Photovoltaic Cell) production equipment are disclosed together.

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更しています。  
2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高に含めていたFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。尚、上記グラフおよびテーブルの2004年3月期までの半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高にはFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を含めて表示しています。  
3. 2009年3月期より、FPD製造装置とPV(太陽電池)製造装置の売上、受注、受注残高を合わせて表示しています。

### Working Capital and Current Ratio

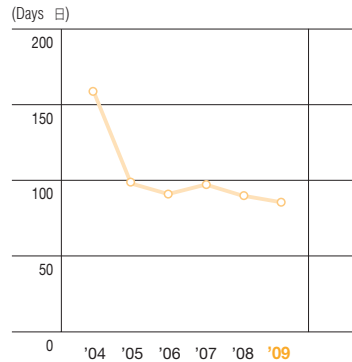
運転資本及び流動比率



■ Working capital 運転資本  
○ Current ratio 流動比率

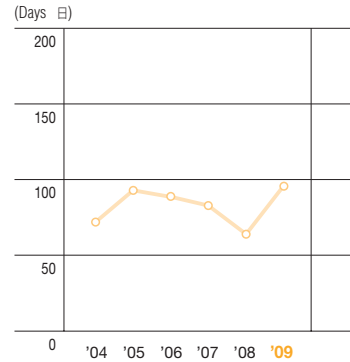
### Receivable Turnover

売上債権回転日数



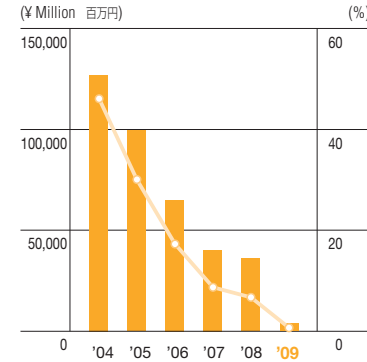
### Inventory Turnover

たな卸資産回転日数



### Interest-Bearing Debt and Debt-to-Equity Ratio

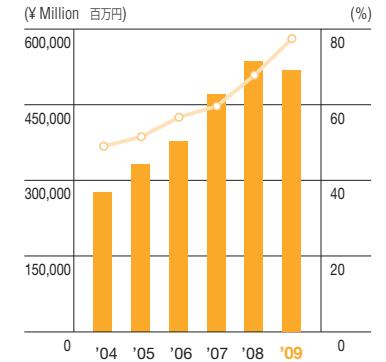
有利子負債及びデット・エクイティ・レシオ



■ Interest-bearing debt 有利子負債  
○ Debt-to-equity ratio デット・エクイティ・レシオ

### Equity and Equity Ratio

自己資本及び自己資本比率



■ Equity 自己資本  
○ Equity ratio 自己資本比率

FY	Working capital (¥ Million)	Current ratio (%)
2004	261,501	284.8
2005	288,574	239.7
2006	315,860	256.7
2007	384,508	270.2
2008	441,412	322.0
2009	416,414	566.5

Working capital = Current assets – Current liabilities  
 運転資本 = 流動資産 – 流動負債  
 Current ratio = Current assets / Current liabilities × 100  
 流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 (%)

FY	Receivable turnover (Days)
2004	159
2005	99
2006	92
2007	98
2008	90
2009	86

Receivable turnover = Trade notes and accounts receivable at fiscal year-end / Net sales × 365  
 売上債権回転日数 = 期末受取手形及び売掛金 ÷ 売上高 × 365

FY	Inventory turnover (Days)
2004	72
2005	93
2006	89
2007	83
2008	65
2009	96

Inventory turnover = Inventories at fiscal year-end / Net sales × 365  
 たな卸資産回転日数 = 期末たな卸資産 ÷ 売上高 × 365

FY	Interest-bearing debt (¥ Million)	Debt-to-equity ratio (%)
2004	127,044	46.1
2005	99,451	29.9
2006	65,100	17.3
2007	40,212	8.7
2008	36,069	6.7
2009	3,806	0.7

Debt-to-equity ratio = Interest-bearing debt / Total equity at fiscal year-end  
 デット・エクイティ・レシオ = 有利子負債 ÷ 期末自己資本 × 100 (%)

FY	Equity (¥ Million)	Equity ratio (%)
2004	275,799	49.1
2005	332,165	51.6
2006	376,900	56.8
2007	460,175	59.7
2008	534,953	67.5
2009	518,387	77.5

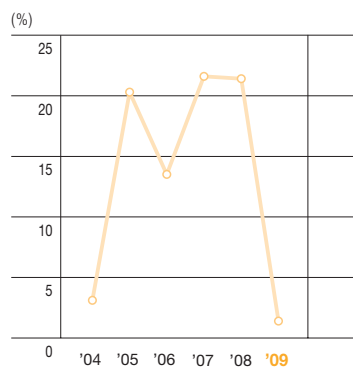
From FY2007, Equity = Net assets – subscription rights to shares – Minority interests  
 2007年3月期より、自己資本 = 純資産 – 新株予約権 – 少数株主持分

Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.  
 2. The figure for trade notes and accounts receivable used for calculation of the receivable turnover does not include the figure for non-trade accounts receivable.  
 3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更  
 2. 売上債権回転日数の計算の元になる「受取手形及び売掛金」の数字には未収金を含んでいません。  
 3. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

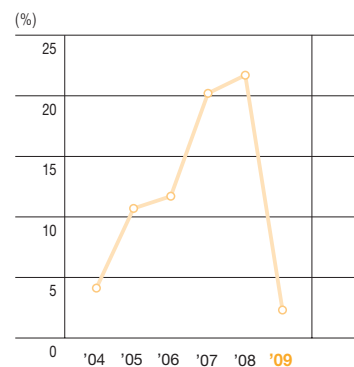
## Return on Equity (ROE)

自己資本利益率



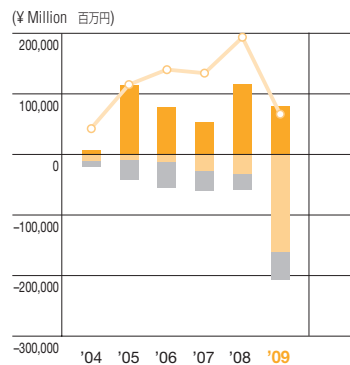
## Return on Assets (ROA)

総資産利益率



## Cash Flows

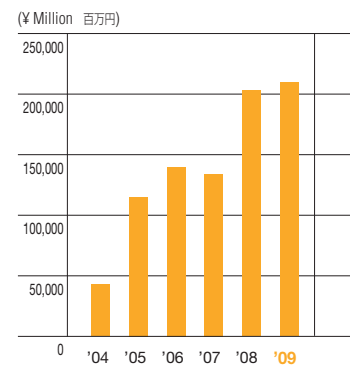
キャッシュ・フロー



■ Cash flow from operating activities  
 営業活動によるキャッシュ・フロー  
 ■ Cash flow from investing activities  
 投資活動によるキャッシュ・フロー  
 ■ Cash flow from financing activities  
 財務活動によるキャッシュ・フロー  
 ○ Cash and cash equivalents at end of year  
 現金及び現金同等物期末残高

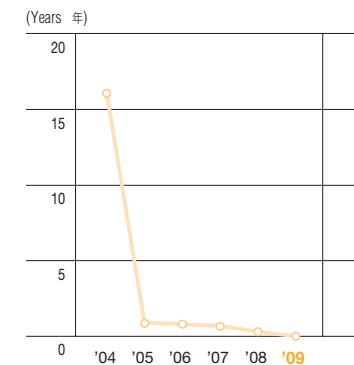
## Total Liquidity on Hand

手元資金



## Redemption of Debt

債務償還年数



FY	ROE (%)
2004	3.1
2005	20.3
2006	13.5
2007	21.8
2008	21.4
2009	1.4

ROE = (Net income / Average total equity) × 100  
 自己資本利益率 = 当期利益 ÷ 期首・期末平均自己資本 × 100 (%)

FY	ROA (%)
2004	4.1
2005	10.7
2006	11.7
2007	20.2
2008	21.7
2009	2.3

ROA = (Operating income + Interest and dividend income) / Average total assets × 100  
 総資産利益率 = (営業利益 + 受取利息及び配当金) ÷ 期首・期末平均総資産 × 100 (%)

FY	Operating	Investing	Financing	End of year
2004	7,883	(8,544)	(10,270)	42,649
2005	114,349	(7,450)	(34,343)	115,420
2006	78,853	(10,536)	(43,420)	140,023
2007	54,296	(25,293)	(34,719)	134,389
2008	116,939	(30,186)	(27,033)	193,492
2009	81,030	(160,621)	(46,015)	65,883

Cash flow from investing activities includes increase / decrease in time deposits over three months.  
 投資活動によるキャッシュ・フローには、3ヶ月超の定期預金の増減が含まれています。

FY	Total liquidity on hand
2004	42,649
2005	115,420
2006	140,023
2007	134,389
2008	203,562
2009	210,158

Total liquidity on hand = Cash and cash equivalents at end of year + time deposits over three months  
 手元資金 = 現金及び現金同等物期末残高 + 3ヶ月超の定期預金残高

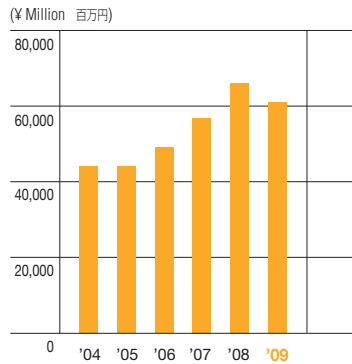
FY	Redemption of debt
2004	16.1
2005	0.9
2006	0.8
2007	0.7
2008	0.3
2009	0.0

Redemption of debt = Interest-bearing debt / Cash flow from operating activities  
 債務償還年数 = 有利子負債 ÷ 営業活動によるキャッシュ・フロー

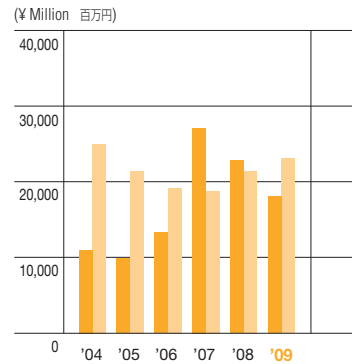
Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.  
 2. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".  
 3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更  
 2. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。  
 3. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

## R&D Expenses 研究開発費

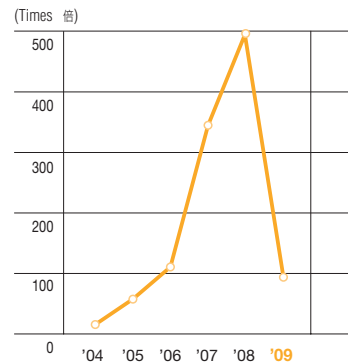


## Capital Expenditures and Depreciation Expenses 設備投資額及び減価償却実施額

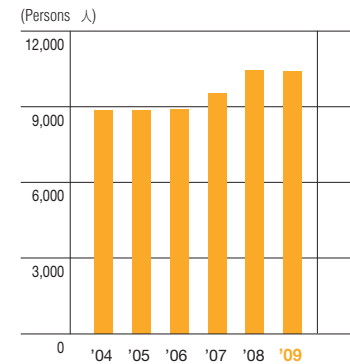


■ Capital expenditures 設備投資額  
■ Depreciation expenses 減価償却実施額

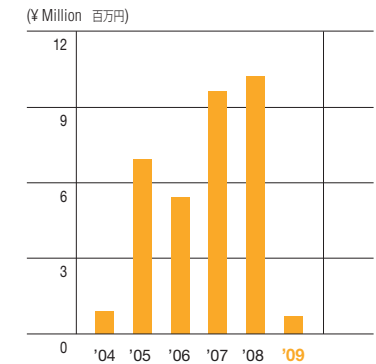
## Interest Coverage Ratio インタレスト・カバレッジ・レシオ



## Number of Employees Worldwide 従業員数



## Net Income per Employee 従業員1人当り当期利益



FY	(¥ Million 百万円) R&D expenses 研究開発費	FY	Capital expenditures 設備投資額	(¥ Million 百万円) Depreciation expenses 減価償却実施額
2004	44,149	2004	11,006	24,962
2005	43,888	2005	9,876	21,462
2006	49,181	2006	13,334	19,170
2007	56,961	2007	27,128	18,820
2008	66,072	2008	22,703	21,413
<b>2009</b>	<b>60,987</b>	<b>2009</b>	<b>18,107</b>	<b>23,068</b>

FY	(Times 倍) Interest coverage ratio インタレスト・カバレッジ・レシオ
2004	16.9
2005	58.7
2006	111.0
2007	344.4
2008	494.9
<b>2009</b>	<b>94.2</b>

FY	(People 人) Number of employees worldwide 従業員数
2004	8,870
2005	8,864
2006	8,901
2007	9,528
2008	10,429
<b>2009</b>	<b>10,391</b>

FY	(¥ Million 百万円) Net income per employee 従業員1人当り当期利益
2004	0.9
2005	6.9
2006	5.4
2007	9.6
2008	10.2
<b>2009</b>	<b>0.7</b>

Interest coverage ratio = (Operating income + Interest and dividend income) / Interest expenses  
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (営業利益 + 受取利息及び配当金) ÷ 支払利息 (倍)

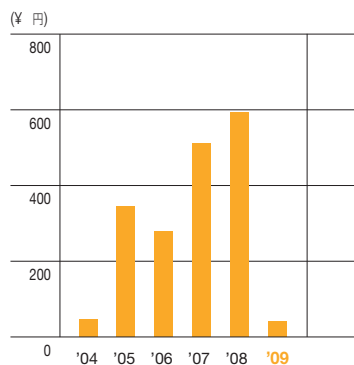
Notes: 1. Amortization of goodwill is not included in depreciation expenses.

2. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"

注) 1. 減価償却実施額には、のれん償却額は含まれておりません

2. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

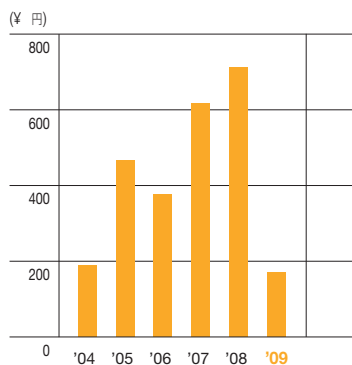
## Net Income per Share 1株当り当期利益



FY	Net income per share (¥)
2004	46.37
2005	343.63
2006	267.61
2007	511.27
2008	594.01
2009	42.15

Net income (loss) per share = Net income (loss) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year  
1株当り当期利益(損失) = 当期利益(損失) ÷ 期中平均発行済株式総数

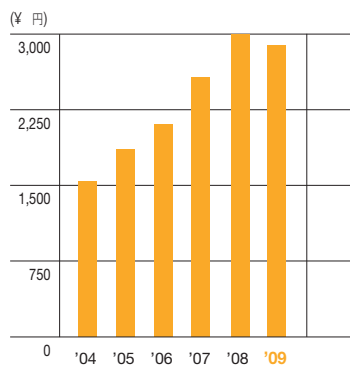
## Cash Flow per Share 1株当りキャッシュ・フロー



FY	Cash flow per share (¥)
2004	188.31
2005	465.99
2006	377.08
2007	616.71
2008	713.70
2009	171.07

Cash flow per share = (Net income + Depreciation and amortization) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year  
1株当りキャッシュ・フロー = (当期利益 + 減価償却費) ÷ 期中平均発行済株式総数

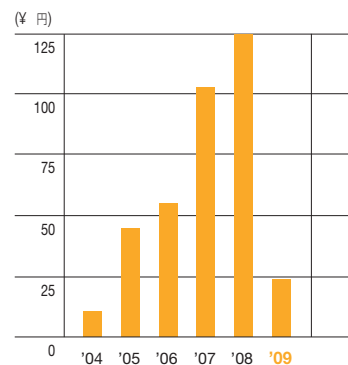
## Net Assets per Share 1株当り純資産



FY	Net assets per share (¥)
2004	1,543.73
2005	1,863.28
2006	2,112.30
2007	2,573.72
2008	2,989.70
2009	2,896.55

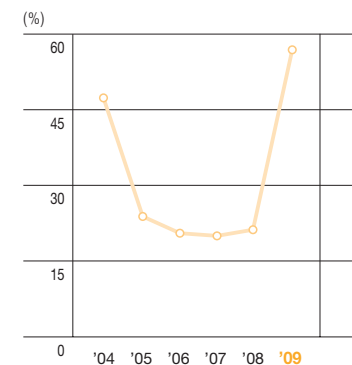
Net assets per share = Net assets / Total number of shares issued  
1株当り純資産 = 期末純資産 ÷ 期末発行済株式総数

## Cash Dividends per Share 1株当り配当金



FY	Cash dividends per share (¥)
2004	10.00
2005	45.00
2006	55.00
2007	103.00
2008	125.00
2009	24.00

## Payout Ratio 配当性向



FY	Payout ratio (%)
2004	47.4
2005	23.9
2006	20.6
2007	20.1
2008	21.0
2009	56.9

Payout ratio = Cash dividends per share / Non-consolidated Net income per share × 100  
配当性向 = 1株当り配当金額 ÷ 単独1株当り当期純利益 × 100 (%)

Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.  
2. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".  
3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".  
4. The number of shares outstanding excluding the treasury stock is used for calculation of per share data.

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更  
2. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。  
3. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。  
4. 1株当り指標の計算には自己株式数を控除後の発行済株式数を使用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Assets 資産の部</b>											
<b>Current assets 流動資産</b>											
Cash and deposits 現金及び預金	46,910	79,518	65,320	48,409	52,982	42,649	115,420	140,023	134,389	67,540	51,156
Securities 有価証券	834	834	—	10	—	—	—	—	19	136,022	159,001
Trade notes and accounts receivable 受取手形・売掛金	133,651	165,053	287,968	157,414	170,286	231,044	172,487	169,038	228,688	224,170	119,687
Inventories たな卸資産	88,084	112,481	161,980	127,352	111,810	105,186	161,489	163,745	194,840	161,151	134,242
Deferred income taxes 繰延税金資産	—	5,305	12,658	3,401	4,151	2,943	18,172	21,356	28,325	24,140	11,480
Allowance for doubtful accounts 貸倒引当金	(1,134)	(1,028)	(1,720)	(620)	(341)	(154)	(114)	(164)	(127)	(62)	(20)
Others その他	22,401	12,991	22,033	17,455	17,549	21,303	27,730	23,488	24,225	27,271	30,139
<b>Total current assets 流動資産合計</b>	<b>290,748</b>	<b>375,157</b>	<b>548,241</b>	<b>353,423</b>	<b>356,438</b>	<b>402,974</b>	<b>495,185</b>	<b>517,487</b>	<b>610,363</b>	<b>640,233</b>	<b>505,687</b>
<b>Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定</b>	<b>—</b>	<b>1,093</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Property, plant and equipment 有形固定資産</b>											
Total property, plant and equipment 有形固定資産	161,564	174,746	211,911	235,247	231,085	223,226	221,752	227,354	244,422	244,241	251,428
Accumulated depreciation 減価償却累計額	(69,471)	(77,019)	(87,190)	(100,736)	(111,474)	(114,437)	(123,336)	(132,616)	(139,492)	(140,135)	(151,521)
<b>Net property, plant and equipment 有形固定資産合計</b>	<b>92,091</b>	<b>97,726</b>	<b>124,720</b>	<b>134,510</b>	<b>119,611</b>	<b>108,788</b>	<b>98,416</b>	<b>94,738</b>	<b>104,930</b>	<b>104,105</b>	<b>99,906</b>
<b>Intangible assets 無形固定資産</b>	<b>601</b>	<b>5,696</b>	<b>27,524</b>	<b>28,753</b>	<b>25,342</b>	<b>21,512</b>	<b>18,611</b>	<b>16,709</b>	<b>19,399</b>	<b>13,253</b>	<b>10,760</b>
<b>Investments and other assets 投資その他の資産</b>											
Investment securities 投資有価証券	17,995	9,009	11,599	9,535	7,216	10,873	10,381	14,860	14,642	8,837	9,131
Deferred income taxes 繰延税金資産	—	2,144	7,394	22,591	9,362	10,203	15,313	13,174	13,691	14,846	31,939
Allowance for doubtful accounts 貸倒引当金	(4)	(234)	(242)	(285)	(431)	(311)	(367)	(374)	(297)	(301)	(7,545)
Others その他	13,469	8,905	10,274	8,387	7,362	7,590	6,779	6,646	7,784	11,843	19,118
<b>Total investments and other assets 投資その他の資産合計</b>	<b>31,461</b>	<b>19,826</b>	<b>29,025</b>	<b>40,227</b>	<b>23,509</b>	<b>28,356</b>	<b>32,106</b>	<b>34,307</b>	<b>35,821</b>	<b>35,224</b>	<b>52,644</b>
<b>Total assets 資産合計</b>	<b>414,902</b>	<b>499,499</b>	<b>729,511</b>	<b>556,915</b>	<b>524,901</b>	<b>561,631</b>	<b>644,319</b>	<b>663,242</b>	<b>770,513</b>	<b>792,817</b>	<b>668,998</b>

Notes: 1. From FY2000, the Company adopts tax-effect accounting.  
2. Non-trade accounts receivable until FY2004 is included in the trade notes and accounts receivable.  
3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment:  
(1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.  
4. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".  
5. From FY2008, certificates of deposit that were previously included in cash and cash equivalents are classified as securities.  
6. From FY2009, the Company adopts "Accounting Standard for Lease Transactions".

注) 1. 2000年3月期より税効果会計を導入しています。  
2. 2004年3月期までの未収金は、受取手形・売掛金に含めています。  
3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2)アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更  
4. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。  
5. 2008年3月期より、従来現金及び預金に含めていた譲渡性預金を有価証券に含めて表示しています。  
6. 2009年3月期より、「リース取引に関する会計基準」を適用しています。



(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Liabilities and Net Assets</b> 負債及び純資産の部											
<b>Current liabilities</b> 流動負債											
Short-term borrowings and commercial paper 短期借入金及びコマーシャルペーパー	21,656	23,997	78,462	23,923	43,729	6,815	975	2,100	1,712	6,069	3,806
Current portion of long-term debt 一年以内返済予定長期借入金及び社債	1,535	32,698	2,969	26,387	37,403	21,753	35,475	24,500	8,500	30,000	—
Trade notes and accounts payable 支払手形及び買掛金	28,135	50,103	60,541	26,625	36,676	65,419	58,229	65,816	83,837	55,332	24,393
Customer advances 前受金	503	1,258	1,817	1,613	1,504	12,141	42,970	33,810	21,956	24,028	28,562
Income taxes payable 未払法人税等	1,488	11,843	41,440	1,663	3,645	3,272	13,357	22,895	45,657	28,239	1,751
Accrued employees' bonuses 賞与引当金	4,117	7,375	10,948	2,463	3,629	6,376	8,644	10,230	14,131	12,726	4,965
Accrued warranty expenses 製品保証引当金	—	—	—	—	—	—	13,105	12,219	14,114	9,815	6,115
Others その他	11,617	19,181	42,261	26,825	34,118	25,692	33,852	30,054	35,945	32,608	19,678
<b>Total current liabilities</b> 流動負債合計	69,054	146,457	238,441	109,501	160,705	141,472	206,611	201,627	225,854	198,820	89,272
<b>Long-term debt, less current portion</b> 長期借入金及び社債	77,709	67,277	126,347	105,451	70,229	98,475	63,000	38,500	30,000	—	—
<b>Accrued pension and severance costs</b> 退職給付引当金	9,344	11,581	28,698	31,714	35,317	37,575	35,632	38,034	40,018	43,704	47,046
<b>Other liabilities</b> その他の固定負債	776	545	2,683	2,610	2,148	4,362	2,499	3,459	4,829	5,047	3,413
<b>Total liabilities</b> 負債合計	156,884	225,861	396,171	249,278	268,401	281,885	307,743	281,621	300,702	247,572	139,732
<b>Foreign currency translation adjustments</b> 為替換算調整勘定	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Minority interest</b> 少数株主持分	25	34	58	58	3,595	3,946	4,410	4,721	—	—	—
<b>Net assets</b> 純資産											
Common stock 資本金	45,531	47,163	47,212	47,213	47,223	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961
Capital surplus 資本剰余金	68,593	70,225	70,274	70,275	70,285	78,023	78,023	78,078	78,346	78,392	78,114
Retained earnings 利益剰余金	144,714	157,875	214,920	190,195	147,464	154,342	212,093	249,938	328,026	410,866	404,435
Treasury stock at cost 自己株式	(1,124)	(1,661)	(3,519)	(5,014)	(13,238)	(13,203)	(16,042)	(15,116)	(12,167)	(11,369)	(11,111)
<b>Total shareholders' equity</b> 株主資本合計	—	—	—	—	—	—	—	—	449,166	532,850	526,398
Unrealized gains on securities 其他有価証券評価差額金	—	—	1,658	1,170	(58)	2,395	2,132	5,117	5,853	2,172	(842)
Deferred gains or losses on hedges 繰延ヘッジ損益	—	—	—	—	—	—	—	—	(177)	460	66
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定	—	—	2,734	3,737	1,228	(719)	997	3,921	5,332	(529)	(7,235)
<b>Total valuation and translation adjustments</b> 評価・換算差額等合計	—	—	—	—	—	—	—	—	11,008	2,102	(8,011)
<b>Share subscription rights</b> 新株予約権	—	—	—	—	—	—	—	—	584	483	1,148
<b>Minority interests</b> 少数株主持分	—	—	—	—	—	—	—	—	9,051	9,807	9,729
<b>Total net assets</b> 純資産合計	257,715	273,602	333,281	307,578	252,904	275,799	332,165	376,900	469,810	545,244	529,265
<b>Total liabilities and net assets</b> 負債及び純資産合計	414,902	499,499	729,511	556,915	524,901	561,631	644,319	663,242	770,513	792,817	668,998

- Notes: 1. From FY2001, the Company adopts new accounting standards for retirement benefits.  
2. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.  
3. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".  
4. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".  
5. From FY2009, the Company adopts "Accounting Standard for Lease Transactions".

- 注) 1. 2001年3月期から退職給付に係る新しい会計基準を適用しています。  
2. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2)アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更  
3. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。  
4. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。  
5. 2009年3月期より、「リース取引に関する会計基準」を適用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Net sales</b> 売上高	313,820	440,728	723,880	417,825	460,580	529,653	635,710	673,686	851,975	906,091	508,082
Cost of sales 売上原価	225,962	303,838	458,902	302,270	326,539	389,498	459,797	483,954	579,325	594,794	370,673
<b>Gross profit</b> 売上総利益	87,857	136,890	264,978	115,555	134,040	140,155	175,912	189,731	272,649	311,297	137,408
Selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費	81,474	101,074	143,891	133,865	132,921	117,875	111,929	114,028	128,670	142,799	122,697
<b>Operating income (loss)</b> 営業利益 (損失)	6,382	35,816	121,086	(18,310)	1,118	22,279	63,982	75,703	143,978	168,498	14,710
Non-operating income 営業外収益	2,706	1,608	1,628	1,796	2,208	2,659	4,533	3,589	4,908	5,131	6,809
Non-operating expenses 営業外費用	2,888	3,585	3,491	2,950	3,557	3,771	2,883	3,340	4,946	916	964
<b>Ordinary income (loss)</b> 経常利益 (損失)	6,200	33,838	119,223	(19,464)	(230)	21,167	65,632	75,951	143,940	172,713	20,555
Unusual or infrequent profit 特別利益	569	908	184	1,471	624	632	7,777	1,141	2,721	3,020	85
Unusual or infrequent loss 特別損失	731	5,058	20,275	4,927	23,405	6,864	17,634	1,765	2,247	6,513	11,004
<b>Income (loss) before income taxes</b> 税金等調整前当期利益 (損失)	6,038	29,689	99,131	(22,919)	(23,010)	14,935	55,775	75,328	144,414	169,219	9,636
Income taxes 法人税等											
Current 法人税・住民税及び事業税	4,167	14,544	50,588	2,612	4,805	5,107	15,540	29,190	60,132	56,568	4,552
Deferred 法人税等調整額	—	(4,708)	(13,489)	(5,602)	13,726	1,015	(21,970)	(2,352)	(7,534)	5,373	(2,762)
Minority interests 少数株主利益	5	5	20	8	12	515	603	484	553	1,005	303
<b>Net income (loss)</b> 当期純利益 (損失)	1,865	19,847	62,011	(19,938)	(41,554)	8,297	61,601	48,005	91,262	106,271	7,543

Notes: 1. From FY2000, the Company adopts tax-effect accounting.

2. Some of the field engineering expenses of service related subsidiaries, which were previously included in selling, general and administrative expenses, are classified as cost of sales from FY2004.

3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

4. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".

5. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

注) 1. 2000年3月期より税効果会計を導入しています。

2. 2004年3月期より、従来販売費及び一般管理費の中に含めていたサービス子会社のフィールドエンジニアリングに関わる費用を売上原価に変更しました。

3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更

4. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。

5. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Cash flows from operating activities</b> 営業活動によるキャッシュ・フロー									
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期純利益 (損失)	99,131	(22,919)	(23,010)	14,935	55,775	75,328	144,414	169,219	9,636
Depreciation and amortization 減価償却費	21,678	26,294	27,373	24,962	21,462	19,170	18,820	21,413	23,068
(Increase) decrease in trade notes and accounts receivable 売上債権の増減額	(121,668)	131,251	(13,661)	(61,789)	59,114	5,144	(58,352)	2,473	102,412
(Increase) decrease in inventories たな卸資産の増減額	(53,665)	28,359	(3,890)	(5,326)	(59,914)	(5,467)	(31,584)	28,342	21,282
Increase (decrease) in trade notes and accounts payable 仕入債務の増減額	9,709	(34,166)	10,351	29,153	(7,440)	6,743	17,236	(27,373)	(29,942)
Income taxes paid 法人税の支払額	(19,596)	(43,848)	(527)	(6,960)	(4,774)	(19,524)	(37,785)	(73,721)	(40,836)
Others その他	34,968	(7,412)	24,757	12,906	50,125	(2,539)	1,548	(3,414)	(4,590)
<b>Net cash provided by (used in) operating activities</b> 営業活動によるキャッシュ・フロー	(29,442)	77,558	21,393	7,883	114,349	78,853	54,296	116,939	81,030
<b>Cash flows from investing activities</b> 投資活動によるキャッシュ・フロー									
Payment into time deposits 定期預金の預入による支出	(30)	—	—	—	—	—	(30,000)	(44,070)	(353,803)
Proceeds from time deposits 定期預金の払戻による収入	—	30	—	—	—	—	30,000	34,000	219,429
Payment for purchase of property, plant and equipment 有形固定資産の取得による支出	(39,155)	(31,006)	(7,028)	(7,530)	(8,679)	(8,600)	(25,153)	(19,338)	(17,227)
Payment for acquisition of intangible assets 無形固定資産の取得による支出	(4,568)	(5,390)	(2,779)	(3,200)	(1,780)	(2,610)	(2,462)	(4,041)	(1,182)
Payment for purchase of newly consolidated subsidiaries 新規連結子会社の取得による支出	(18,867)	—	—	—	—	—	—	—	—
Others その他	262	577	2,538	2,186	3,009	674	2,323	3,263	(7,836)
<b>Net cash used in investing activities</b> 投資活動によるキャッシュ・フロー	(62,359)	(35,789)	(7,269)	(8,544)	(7,450)	(10,536)	(25,293)	(30,186)	(160,621)
<b>Cash flows from financing activities</b> 財務活動によるキャッシュ・フロー									
Increase (decrease) in debt 借入債務の増減額	83,778	(51,681)	(4,011)	(8,624)	(27,618)	(34,438)	(24,904)	(4,148)	(32,262)
Dividends paid 配当金の支払額	(4,733)	(4,030)	(1,395)	(1,409)	(3,742)	(9,795)	(12,843)	(23,431)	(13,420)
Others その他	(1,863)	(1,501)	(4,476)	(237)	(2,982)	813	3,027	546	(332)
<b>Net cash provided by (used in) financing activities</b> 財務活動によるキャッシュ・フロー	77,182	(57,213)	(9,883)	(10,270)	(34,343)	(43,420)	(34,719)	(27,033)	(46,015)
<b>Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents</b> 現金及び現金同等物に係る換算差額	391	(1,436)	332	599	214	(340)	81	(617)	(2,068)
<b>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</b> 現金及び現金同等物の増減額	(14,228)	(16,881)	4,573	(10,332)	72,770	24,555	(5,634)	59,103	(127,676)
<b>Cash and cash equivalents at beginning of year</b> 現金及び現金同等物期首残高	79,518	65,290	48,409	52,982	42,649	115,420	140,023	134,389	193,492
<b>Effect of newly consolidated subsidiary</b> 新規連結子会社の影響	—	—	—	—	—	48	—	—	67
<b>Cash and cash equivalents at end of year</b> 現金及び現金同等物期末残高	65,290	48,409	52,982	42,649	115,420	140,023	134,389	193,492	65,883

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2003				2004				2005				
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	1H	2Q	3Q	4Q
<b>Net sales</b> 売上高	92,307	131,080	96,993	140,198	87,778	133,637	121,234	187,002	280,199	149,409	206,101	149,076	206,101
Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置	71,275	105,950	75,391	112,071	65,320	106,912	96,496	157,017	206,063	102,050	149,076	102,050	149,076
FPD/PV Production Equipment FPD/PV製造装置									21,014	25,266	28,757	25,266	28,757
Electronic Components 電子部品	17,369	19,989	18,207	21,813	18,768	21,141	20,619	23,698	45,136	18,679	22,432	18,679	22,432
Computer Network コンピュータ・ネットワーク	3,334	4,791	3,094	5,971	3,397	5,244	3,815	5,989	7,357	3,123	5,486	3,123	5,486
Others その他	327	348	299	342	291	338	302	296	627	289	349	289	349
<b>Cost of sales</b> 売上原価	66,272	88,893	66,914	104,458	66,607	98,539	91,461	132,889	203,497	106,991	149,308	106,991	149,308
<b>Gross profit</b> 売上総利益	26,034	42,187	30,078	35,740	21,171	35,097	29,772	54,113	76,702	42,417	56,792	42,417	56,792
Gross profit margin 売上総利益率	28.2%	32.2%	31.0%	25.5%	24.1%	26.3%	24.6%	28.9%	27.4%	28.4%	27.6%	28.4%	27.6%
<b>Selling, general and administrative expenses</b> 販売費及び一般管理費	32,176	35,543	31,600	33,600	29,465	31,598	25,592	31,218	56,426	25,403	30,099	25,403	30,099
<b>Operating income (loss)</b> 営業利益(損失)	(6,141)	6,643	(1,522)	2,139	(8,294)	3,499	4,180	22,894	20,275	17,013	26,693	17,013	26,693
Operating margin 営業利益率	(6.7%)	5.1%	(1.6%)	1.5%	(9.4%)	2.6%	3.4%	12.2%	7.2%	11.4%	13.0%	11.4%	13.0%
<b>Ordinary income (loss)</b> 経常利益(損失)	(6,744)	6,043	(1,853)	2,325	(8,740)	3,115	4,040	22,751	20,984	17,410	27,237	17,410	27,237
Ordinary profit margin 経常利益率	(7.3%)	4.6%	(1.9%)	1.7%	(10.0%)	2.3%	3.3%	12.2%	7.5%	11.7%	13.2%	11.7%	13.2%
<b>Income (loss) before income taxes</b> 税金等調整前当期利益(損失)	(6,264)	5,564	(1,921)	(20,389)	(9,001)	407	3,808	19,721	7,943	17,354	30,476	17,354	30,476
Ratio of income before income taxes to net sales 税金等調整前当期利益率	(6.8%)	4.2%	(2.0%)	(14.5%)	(10.3%)	0.3%	3.1%	10.5%	2.8%	11.6%	14.8%	11.6%	14.8%
<b>Net income (loss)</b> 当期純利益(損失)	(4,171)	1,633	(166)	(38,850)	(10,366)	559	2,751	15,352	1,272	13,401	46,927	13,401	46,927
Net income margin 当期純利益率	(4.5%)	1.2%	(0.2%)	(27.7%)	(11.8%)	0.4%	2.3%	8.2%	0.5%	9.0%	22.8%	9.0%	22.8%

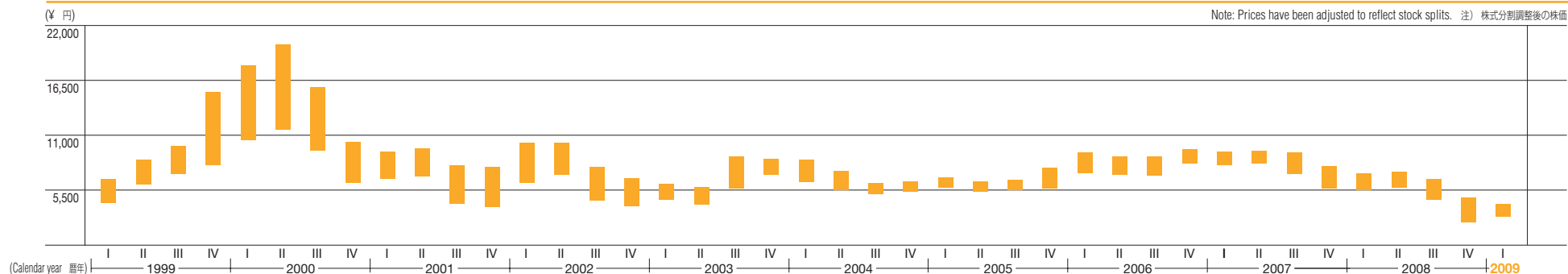
(¥ Million 百万円)

2006				2007				2008				2009			
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
160,016	173,122	145,058	195,488	179,205	211,357	210,093	251,318	212,494	263,883	199,837	229,876	154,827	146,398	101,088	105,767
113,984	125,274	104,568	143,054	125,925	157,980	158,828	199,891	165,785	213,465	160,739	186,449	112,546	96,156	57,827	58,852
23,914	19,122	16,663	21,475	28,932	23,636	26,023	22,173	21,400	22,200	10,048	14,367	17,264	22,915	20,370	27,557
18,603	23,306	20,273	24,697	21,042	24,011	21,141	22,098	25,175	28,095	28,980	28,929	24,923	27,202	22,835	19,246
3,189	5,089	3,289	5,929	3,009	5,438	3,857	6,862								
323	329	263	331	294	290	242	293	132	121	69	130	93	124	55	110
113,512	130,400	100,141	139,899	124,765	146,405	136,150	172,004	135,907	175,110	127,411	156,364	102,729	107,441	73,974	86,529
46,503	42,721	44,917	55,589	54,439	64,951	73,943	79,314	76,586	88,773	72,426	73,511	52,098	38,957	27,114	19,238
29.1%	24.7%	31.0%	28.4%	30.4%	30.7%	35.2%	31.6%	36.0%	33.6%	36.2%	32.0%	33.6%	26.6%	26.8%	18.2%
24,770	28,212	27,956	33,090	28,575	32,575	31,038	36,481	33,551	36,802	33,927	38,518	30,668	34,104	29,115	28,809
21,733	14,509	16,961	22,499	25,864	32,376	42,904	42,833	43,034	51,970	38,499	34,993	21,430	4,852	(2,001)	(9,570)
13.6%	8.4%	11.7%	11.5%	14.4%	15.3%	20.4%	17.0%	20.3%	19.7%	19.3%	15.2%	13.8%	3.3%	(2.0%)	(9.0%)
21,717	15,037	16,965	22,231	26,739	31,465	42,116	43,620	41,175	54,620	39,761	37,155	22,263	6,644	(74)	(8,278)
13.6%	8.7%	11.7%	11.4%	14.9%	14.9%	20.0%	17.4%	19.4%	20.7%	19.9%	16.2%	14.4%	4.5%	(0.1%)	(7.8%)
22,083	14,490	16,983	21,769	27,320	31,173	42,120	43,799	42,483	55,718	40,015	31,002	22,253	6,439	(8,494)	(10,562)
13.8%	8.4%	11.7%	11.1%	15.2%	14.7%	20.0%	17.4%	20.0%	21.1%	20.0%	13.5%	14.4%	4.4%	(8.4%)	(10.0%)
13,237	10,741	10,147	13,879	16,282	20,942	26,987	27,050	26,192	36,270	25,600	18,207	12,853	4,508	(7,686)	(2,132)
8.3%	6.2%	7.0%	7.1%	9.1%	9.9%	12.8%	10.8%	12.3%	13.7%	12.8%	7.9%	8.3%	3.1%	(7.6%)	(2.0%)

- Notes: 1. Sales of FPD production equipment until FY2004 are included in the sales of semiconductor production equipment.  
2. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.  
3. As changes in accounting policies were made in the second quarter (2Q) of FY2005, aggregate figures for the first quarter (1Q) and the second quarter (2Q) of FY2005 are provided.  
4. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".  
5. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".  
6. From FY2008, sales of "Electronic components" and "Computer networks", which were disclosed separately, are combined as "Electronic Components & Computer Networks".  
7. From FY2009, FPD production equipment and PV (Photovoltaic Cell) production equipment sales are disclosed together.

- 注) 1. 2004年3月期までのFPD製造装置売上高は、半導体製造装置売上高に含まれています。  
2. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更 (2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更  
3. 会計方針の変更が2005年3月期の第2四半期に行なわれたため、2005年3月期の第1四半期と第2四半期の数字につきましては合算にて表示しています。  
4. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。  
5. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。  
6. 2008年3月期より、従来電子部品およびコンピュータ・ネットワークで個別に開示していた売上高を、電子部品・情報通信機器として開示しています。  
7. 2009年3月期より、FPD製造装置とPV(太陽電池)製造装置の売上を合わせて開示しています。

## Stock Price Range 株価の推移



Years ended March 31	各3月31日までの1年間	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
High (¥)	高値 (円)	6,630	18,000	20,090	10,260	10,280	8,920	7,390	9,270	9,650	9,410	7,360
Low (¥)	安値 (円)	2,755	6,080	6,240	3,820	3,870	4,070	5,110	5,350	6,980	5,540	2,305

Note: Prices have been adjusted to reflect stock splits. 注) 株式分割調整後の株価

PER (Times)	High	株価収益率 (倍)	最高	619.6	158.5	56.8	—	—	192.4	21.5	34.6	18.9	15.8	174.6
	Low		最低	257.5	53.6	17.6	—	—	87.8	14.9	20.0	13.7	9.3	54.7
PBR (Times)	High	株価純資産倍率 (倍)	最高	4.5	11.5	10.6	5.8	7.1	5.8	4.0	4.4	3.7	3.1	2.5
	Low		最低	1.9	3.9	3.3	2.2	2.7	2.6	2.7	2.5	2.7	1.9	0.8
PCFR (Times)	High	株価キャッシュ・フロー倍率 (倍)	最高	58.4	80.1	42.1	282.6	—	47.4	15.9	24.6	15.6	13.2	43.0
	Low		最低	24.3	27.1	13.1	105.2	—	21.6	11.0	14.2	11.3	7.8	13.5

Price / earnings ratio = Common stock price / Net income per share 株価収益率 = 株価 ÷ 1株当り当期純利益

Price / book value ratio = Common stock price / Net assets per share 株価純資産倍率 = 株価 ÷ 1株当り純資産

Price / cash flow ratio = Common stock price / Cash flow per share 株価キャッシュ・フロー倍率 = 株価 ÷ 1株当りキャッシュ・フロー

## Number of Shares Issued (Fiscal Year-End) 発行済株式数の推移 (期末)

FY 年度	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Number of shares issued (Thousand) 発行済株式数 (千株)	174,624	175,660	175,691	175,691	175,698	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611
Market capitalization (¥ Billion) 時価総額 (十億円)	1,070.4	2,722.7	1,454.7	1,583.0	815.2	1,255.2	1,103.5	1,466.6	1,488.2	1,094.5	657.4	

Market capitalization = Closing stock price at fiscal year-end × Number of shares issued 時価総額 = 期末株式終値 × 発行済株式数

## Public Offering of Common Stock 公募増資の実績

### Public Offering of Common Stock 有償・公募

Date of issue 発行年月日	Subscribed shares (Thousands) 発行株式数 (千株)	Issuing price (¥) 発行価格 (円)
June 2, 1980	1,980年6月2日	4,131
July 1, 1981	1981年7月1日	2,000
October 16, 1982	1982年10月16日	4,000
May 6, 1983	1983年5月6日	20
June 23, 1984	1984年6月23日	3,000
November 15, 1989	1989年11月15日	6,000

### Stock Splits 株式分割

Date of issue 発行年月日	Ratio of distribution 分割比率	
October 1, 1980	1980年10月1日	1:1.25
October 1, 1981	1981年10月1日	1:1.3
November 20, 1982	1982年11月20日	1:1.3
February 1, 1983	1983年2月1日	1:2.0
November 20, 1984	1984年11月20日	1:1.2
November 15, 1989	1989年11月15日	1:1.1
November 15, 1990	1990年11月15日	1:1.2
May 20, 1997	1997年5月20日	1:1.1

## Major Shareholders (Top 10) 大株主一覧 (上位10位)

As of March 31, 2009 2009年3月31日現在

Name 株主名	Shares (Thousands) 所有株式数 (千株)	Percentage 持株比率 (%)
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	22,509	12.5%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	14,755	8.2%
Tokyo Broadcasting System, Inc. 株式会社東京放送	8,727	4.8%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 4) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口4)	6,926	3.8%
State Street Bank and Trust Company 505225 ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 505225	3,760	2.1%

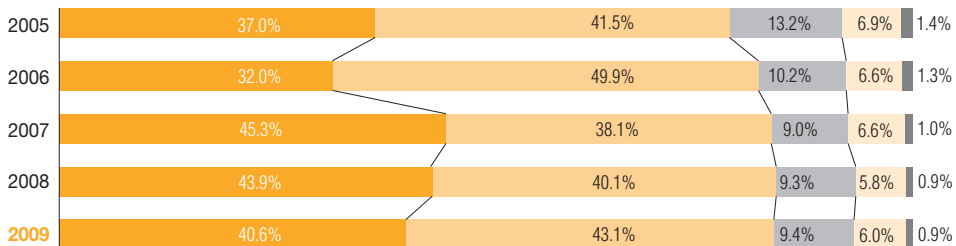
Name 株主名	Shares (Thousands) 所有株式数 (千株)	Percentage 持株比率 (%)
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000	1.7%
Trust & Custody Services Bank, Ltd.(trust account) 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	2,986	1.7%
BBH For VIP Contrafund Info Tech Sub ビービーエイチファイアイビーコントラファンドインフォテックサブ	2,937	1.6%
JP Morgan Securities Japan Co., Ltd. JPモルガン証券株式会社	2,810	1.6%
Melon Bank, N. A. As Agent For Its Client Melon Omnibus US Pension メロンバンク エヌエーアズ エージェントフォー イッツ クライアントメロン オムニバス ユーエス ペンション	2,544	1.4%

## Composition of Shareholders by Category 所有者別分布状況

As of March 31, 2009 2009年3月31日現在

Category 区分	2005			2006			2007			2008			2009		
	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition			Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition			Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition			Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition			Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition		
	株主数	株式数 (千株)	構成比	株主数	株式数 (千株)	構成比	株主数	株式数 (千株)	構成比	株主数	株式数 (千株)	構成比	株主数	株式数 (千株)	構成比
Japanese financial institutions and securities companies 金融機関・証券会社	207	66,817	37.0%	202	57,748	32.0%	256	81,793	45.3%	262	79,240	43.9%	188	73,325	40.6%
Foreign institutions and others 外国法人等	553	74,864	41.5%	600	90,081	49.9%	623	68,775	38.1%	639	72,365	40.1%	643	77,898	43.1%
Japanese individuals and others 個人・その他	59,415	23,902	13.2%	44,930	18,408	10.2%	39,837	16,247	9.0%	41,871	16,739	9.3%	41,232	16,958	9.4%
Other Japanese corporations その他の法人	681	12,498	6.9%	539	12,037	6.6%	572	11,983	6.6%	551	10,588	5.8%	445	10,785	6.0%
Treasury stock 自己株式	1	2,530	1.4%	1	2,336	1.3%	1	1,813	1.0%	1	1,679	0.9%	1	1,643	0.9%
Total 合計	60,857	180,611	100.0%	46,272	180,611	100.0%	41,289	180,611	100.0%	43,324	180,611	100.0%	42,509	180,611	100.0%

Number of shareholders and shares includes number of odd lot shareholders and odd lot shares.  
株主数及び株式数は、単元未満株主数及び単元未満株式数を含んでいます。



■ Japanese financial institutions and securities companies 金融機関・証券会社  
■ Foreign institutions and others 外国法人等  
■ Japanese individuals and others 個人・その他  
■ Other Japanese corporations その他の法人  
■ Treasury stock 自己株式



TOKYO ELECTRON LIMITED



**World Headquarters**

Akasaka Biz Tower  
3-1, Akasaka 5-chome  
Minato-ku, Tokyo 107-6325, Japan  
Tel: +81-3-5561-7000  
Fax: +81-3-5561-7400  
URL: <http://www.tel.com>

**Investor Relations**

**Corporate Communications Dept.**

Tel: +81-3-5561-7003  
Fax: +81-3-5561-7400

Printed on recycled paper.  
本誌は再生紙を使用しています。

Printed in Japan  
PR47-118